

证券代码：002669

证券简称：康达新材

康达新材料（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	中信建投证券：周舟；华宝基金：郭祝同；野村资管：吴刚祥。
时间	2026年3月16日 10:30—12:00
地点	上海市浦东新区五星路 707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	常务副总经理、董事会秘书：沈一涛；投资者关系专员：安琪
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事会秘书沈一涛对公司业务情况进行了介绍，同时对 2025 年度业绩预告变动原因及重点项目推进进度等作了详细说明。</p> <p>Q1:请介绍一下公司 2025 年度业绩预告中业绩同比变化较大的主要原因？</p> <p>A: 公司 2025 年度业绩预计实现扭亏为盈，主要得益于胶粘剂与特种树脂新材料板块产品销售大幅增长，其中风电行业景气度提升带动风电叶片相关产品需求旺盛、销量显著增加，成为推动利润增长的核心因素。同时，公司通过优化产业布局、提升资产质量，进一步增强了整体盈利能力。具体财务数据及分析请以 2025 年年度报告披露数据及信息为准。</p> <p>Q2:请介绍一下公司如何展望风电叶片行业？</p> <p>A: 2025 年公司胶粘剂与特种树脂新材料板块呈现良好发展态势，产品销售总量稳步增长，同步带动板块净利润提升。2026 年作为“十五五”规划开局之年，公司将密切关注行业政策及市场变化，依托自身在风电叶片用环氧结构胶、灌注树脂等产品方面的积累，稳步做好生产经营与市场拓展工作，努力实现业务平稳健康发展。同时，公司将持续通过技术创新、市场开拓、成本管控等方式，积极应对行业波动与市场竞争，不断夯实自身核心竞争力与行业地位。</p>

	<p>Q3: 公司的环氧树脂结构胶、灌注树脂去年销售情况及市场占有率情况如何?</p> <p>A: 2025 年前三季度, 公司风电环氧树脂结构胶、灌注树脂销售同比实现稳步增长, 市场地位持续巩固。其中, 风电叶片用环氧结构胶国内市场占有率第一, 环氧灌注树脂国内份额保持领先。</p> <p>Q4: 近期受外部因素影响, 国内环氧树脂原材料等原材料价格大幅上涨, 请问贵公司生产的环氧灌注树脂相关产品是否有上调价格的预期, 如何应对原材料价格提升?</p> <p>A: (1) 公司积极布局上游原材料环节, 并根据市场变化灵活调整生产节奏, 保障长期稳定供应, 并优化采购成本; (2) 紧密跟踪原材料市场的供需变化及价格波动, 通过长期协议、预付款安排等多种举措, 筑牢供应链的长期稳定与安全, 有效平抑成本波动; (3) 与下游客户协商, 通过原材料价格联动等方式议定产品价格, 共同分担成本压力。</p> <p>Q5: 请介绍一下公司在电子级特种树脂领域已有哪些技术储备与布局?</p> <p>A: 公司控股公司康成达创(上海)新材料有限公司主要规划产品为电子级双(多)马来酰亚胺树脂, 可应用于高速覆铜板、BT 载板等领域。目前已通过部分客户的技术验证, 并形成小批量供货, 暂未对营收产生重大影响。</p> <p>Q6: 请介绍一下公司的 CMP 抛光液及项目进展情况?</p> <p>A: CMP 抛光液是应用于半导体制造过程中的化学机械抛光 (Chemical Mechanical Polishing, 简称 CMP) 工艺的材料。作为公司半导体材料板块核心布局方向之一, 与 ITO 靶材、氧化铝靶材、低温共烧陶瓷 (LTCC) 等共同构成无机半导体材料业务矩阵, 目前公司氧化铈抛光液 (CMP) 项目按照预期计划争取 4 月底前向目标客户送样, 在 2026 年依据客户反馈优化产品并实现小批量生产。</p> <p>Q7: 请介绍一下公司中长期战略方向?</p> <p>A: 公司通过近年来的布局与发展, 形成了以胶粘剂与特种树脂新材料系列产品为主链, 高端电子信息材料为支撑的第二增长曲线发展模式。公司以现有半导体材料产业布局为基础, 通过多元化投资模式, 加速向半导体产业战略转型升级, 努力打造第三增长曲线。公司战略布局高度契合国家产业政策导向, 符合公司长远发展和战略规划。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 3 月 16 日